

有研半导体硅材料股份公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

为切实履行上市公司的责任和义务，持续提升公司业绩与治理水平，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）结合自身经营发展情况，于2026年3月发布了《有研硅2026年度“提质增效重回报”行动方案》。报告期内，公司积极推进方案中各项工作的落地实施，并就上半年执行情况进行总结，编制形成《有研硅2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。具体内容如下：

一、抢抓市场机遇，提升经营质效

2026年，全球半导体硅片市场步入新一轮上行周期，量价齐升态势明确。从需求结构来看，各应用领域呈现明显分化：人工智能（AI）等前沿应用驱动的先进计算需求持续强劲增长；消费电子领域在经历前期缓慢复苏后，于本年度实现显著回暖；工业半导体领域亦稳步回温，车用、工控等非AI市场正逐步复苏；受海外大厂产能向高端算力、存储转移，下游细分存储供需趋紧，带动半导体材料需求上升。

公司紧抓市场机遇，深耕半导体硅材料主营业务，实现经营业绩稳步增长。2026年上半年，实现营业收入66,480.69万元，同比增长21.20%；归属于母公司所有者的净利润13,282.52万元，同比增加25.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润8,883.46万元，同比增加20.99%。

报告期内，公司产能建设稳步推进。硅片产品产销量同比分别增长约3%、15%，其中8英寸硅片产销量再创新高，同比分别增长约18%、27%；刻蚀设备用单晶及多晶材料、刻蚀设备用部件产品上半年产销量和销售收入同比均实现大幅度增长；区熔单晶产品的产销量同比分别增长约19%、17%，销售收入同比增长约15%，实现小幅攀升。

报告期内，公司募投项目整体进展顺利，各项工作按计划有序推进。“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”于2026年二季度末实现新增产能5万片/月，目

前 8 英寸硅片已达成 30 万片/月产能。“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”结合市场环境与公司发展战略，对投资节奏及部分设备配置进行了审慎调整，该募投项目计划于 2026 年底实现项目目标，公司将优先推进对应产能的市场开拓，确保已有产能充分利用。“8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目”正按计划积极推进中，预计 2026 年底建成，达产后可新增 8 英寸区熔单晶产能 21 吨/年。

“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”由国晶半导体材料（包头）有限公司（以下简称“包头国晶”）负责实施，项目已于 2026 年 7 月开工建设，规划建设约 5 万平方米的单晶厂房，预计 2027 年 12 月达到预定可使用状态。达产后可形成年产集成电路硅材料用单晶硅及集成电路刻蚀设备用单晶硅 1,000 吨以上的生产能力。

报告期内，公司围绕降本增效、提质控险、优化供应链等工作，从技术降本、价格管控、供应保障等方面持续推进提质增效工作。在技术降本方面，公司按产品分类推进多项技术改造项目，不断提高产品收率，提升单位产出效能，有效降低生产成本。在价格管控方面，公司通过提高国产化应用比例等举措，控制采购成本。在供应保障方面，公司采取提前预判下单、动态跟踪交期及应急保供等方式，确保所有物料的及时供应。在供应商管理方面，公司持续优化供应商结构，加大合格供应商储备，核心物料保持多家备选渠道，有效提升供应链应急抗风险能力，在降低采购成本的同时，进一步增强供应链的稳定性与安全性。

二、加大股权投资，培育增长新引擎

1、完成 DGT 股权收购，补齐产业链下游环节

2026 年 1 月，公司完成对株式会社 DG Technologies（以下简称“DGT”）70%股权的收购，本次收购有利于公司完善产业链布局，增强公司制造终端产品的能力，补齐产业链下游环节；有利于公司拓展国际市场，提升产品品牌的全球知名度。报告期内，公司充分发挥 DGT 客户资源优势，积极拓展增量业务机会。

2、投建大尺寸单晶基地，夯实规模化发展根基

2026 年 3 月，公司设立全资子公司包头国晶投资新建“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”，该项目基地计划投资人民币 40,000.00 万元，于 2026 年 7 月开工建设，预计 2027 年 12 月达到预定可使用状态。达产后可形成年产集成电路硅材料用单晶硅及集成电路刻蚀设备用单晶硅 1,000 吨以上的生产能力。本项

目依托新基地的电力成本优势，建设高质量低成本单晶基地，有助于提升供货能力，巩固并提高产品的市场占有率和盈利能力。同时，项目将为公司半导体硅片规模化发展提供坚实保障，并为“十五五”期间布局新兴业务领域奠定基础，增强公司整体竞争力和行业影响力，推动公司发展战略稳步落地。

3、收购安徽晶隆半导体，完善外延业务新布局

2026年6月，公司以公开竞价摘牌方式参与收购安徽晶隆半导体科技有限公司（以下简称“安徽晶隆”）60%股权。2026年7月6日，公司与滁州市南谯区国有资产运营有限公司签署了《产权交易合同》，确认公司成为安徽晶隆60%股权的受让方，交易价格为45,070.692万元。截至本报告披露日，公司已支付全部交易价款，并已完成股权交割及工商变更登记。本次收购有助于公司向下游硅外延环节延伸，形成从衬底材料到外延产品的一站式解决方案，从而实现补链强链，进一步提升公司产品综合竞争力。

4、合资设立北京晶研半导体，合作赋能共赢发展

2026年3月，有研硅与北京东能良品科技有限公司、晶硅(北京)半导体设备技术中心(普通合伙)共同出资设立北京晶研半导体设备有限公司，注册资本3,000万元，主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，有研硅持股30%。

三、聚力技术攻坚，筑牢人才根基

1、聚力研发攻关，加速成果落地

报告期内，公司持续加强研发团队建设，保障研发投入，持续提升核心竞争力。2026年上半年，公司累计投入研发费用4,344.80万元，占营业收入的6.54%。

报告期内，公司及各子公司研发平台建设与科技项目攻关取得积极进展：有研硅“国家企业技术中心”顺利通过国家发展和改革委员会2025年度运行评价；依托山东有研半导体建设的“山东省硅单晶半导体材料与技术重点实验室”成功通过山东省科技厅绩效评价。此外，报告期内公司新增发明专利4项、实用新型1项、软件著作权2项。

在新产品研发方面，8英寸区熔气掺硅片、功率器件用8英寸红磷重掺杂超低阻硅片及8英寸直拉低氧新品均获得多家客户认证，并实现批量销售；8英寸BCD用硅片客户认证工作稳步推进；继续深入开发刻蚀设备用零部件系列产品，

并获得国内重要设备客户认证，进一步拓展了公司在半导体设备耗材领域的市场布局；多晶产品生产工艺保持稳定，并实现批量销售；大尺寸多晶环片实现批量供应；公司自主研发的超大尺寸硅单晶已进入客户认证阶段。

在新技术攻关方面，搭建新型拉晶平台，并取得阶段性进展；轻掺单晶品质一致性进一步提升；开发并应用智能拉晶技术，升级了控制模式，提高了劳动效率和过程稳定性。

2、完善人力机制，筑牢梯队根基

2026年上半年，公司紧扣研发创新主线落实人才强企战略，从机制建设、技能培训、考核激励、青年培育多维度布局，汇聚科创人才资源，筑牢技术攻关的人才根基。公司结合研发战略完成全域人才盘点，厘清核心岗位架构与梯队储备，为技术骨干制定个性化培养方案，补齐紧缺人才，实现人员结构匹配技术研发需求。围绕技术攻关、研发管理等内容开展专项培训，针对管理层、工程技术人员分层组织学习活动，整体提升团队研发管理与实操攻坚水平。

绩效管理层面升级“KPI+”评价模式，向技术迭代、工艺攻关、研发降本等创新贡献倾斜激励权重，依据经营数据动态调整指标，刚性兑现奖惩，充分释放研发队伍创新内生动力。依托“晨星计划”深耕青年研发人才储备，借助导师带徒、轮岗学习、项目实战历练等方式，加快应届生与青年骨干成长，为技术创新输送新鲜血液。

四、优化财务管理，促进降本增效

1、加强成本控制，保持盈利质量

2026年上半年，公司持续优化高效协同，积极提升内部运营流程效率。通过预算动态管控机制，结合生产订单、原料行情、产能负荷、市场环境实时滚动调整各项经营预算。做好事前规划、偏差复盘等闭环管理，控制物料库存积压、合理调配使产能达到充分利用；同时紧盯成本指标达成情况，推动全员树立成本意识，精准识别生产低效环节，不断优化资源配置、提升产能利用率与资金周转效率，促进企业全方位降本提质增效。后续公司将持续强化成本精细化管理和流程优化，在保证产品质量的前提下降低成本，进一步提升产品市场竞争力。

2、加强现金管理，优化资金使用配置

持续关注经营回款，维持健康的经营性现金流，上半年经营活动现金流净额20,762.93万元，确保储备安全的经营现金，保持高效的资金使用效率。

募集资金方面，募投项目实施过程中严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目顺利推进，促进公司主营业务发展。自有资金方面，公司在不影响正常经营需求和保证资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，使得资金收益最大化。

在资金投资方面，公司抓住机会实现投资及并购整合。通过新设公司及股权并购整合上下游资源、布局优质赛道，把货币资金转化为可产生收益的权益资产，拓宽盈利渠道，实现资本增值与整体资金效益最大化，为公司经营规模发展壮大，实现“十五五”规划奠定坚实的基础。

五、坚持规范运作，筑牢内控防线

2026年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求，确保股东会、董事会、管理层权责清晰、规范运作。2026年上半年，公司共召开股东会3次，董事会5次，董事会专门委员会7次，独董专门会议3次，董事会及各专门委员会、独立董事、管理层履职尽责，对审议事项进行了认真讨论和科学决策。

报告期内，公司为进一步健全薪酬治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025年10月修订），对《有研硅董事薪酬管理制度》《有研硅高级管理人员薪酬管理制度》进行了系统修订，明确了管理机构、细分了薪酬构成，并新增责任追溯、止付追索等情况。同步制定了《有研硅薪酬管理办法》，规定了全体在岗员工的薪酬管理原则、工资总额决定机制、动态调整机制及发放管理等，强化了薪酬管理的约束效力与合规性，能够更好地保障股东利益，助力公司健康可持续发展。

报告期内，公司持续深化内控管理，针对重点风险领域与关键环节组织开展专项审计及监督检查，不断强化内控风险防控水平。公司完善反舞弊管理机制，明确反舞弊重点领域、关键环节及管控要点，并在内部审计实施过程中持续关注、排查潜在舞弊风险。

六、提升信披质量，加强投关沟通

2026 年上半年，公司高度重视信息披露工作，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司累计发布定期报告 2 份，临时公告 30 份。报告期内，公司 ESG 评级实现稳步跃升，《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》荣获国内主流 ESG 评级机构万得、中诚信、华证、秩鼎“A”评级，标志着公司可持续发展实践获得市场高度认可。

2026 年上半年，公司持续加强与投资者的沟通交流，报告期内组织开展多场投资者交流活动，同时借助路演及反路演平台积极展示公司价值，增强市场认同，进一步提升公司在资本市场的透明度和品牌形象。在业绩说明会上，公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事等积极参与交流，系统全面介绍了公司经营成果、产业发展、未来规划等，并就投资者重点关注的问题进行充分交流。公司通过上证 E 互动平台、投资者热线、电子邮件等多种渠道与投资者保持充分沟通交流，让投资者能够更加清晰、全面地了解公司经营情况。

七、践行分红承诺，切实提升股东获得感

公司秉承积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，切实提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，持续履行对投资者的回报承诺。2026 年上半年，根据 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东共计派发现金红利 6,857.11 万元（含税），占 2025 年度（调整前）归属于上市公司股东净利润的 32.77%，现金分红派发工作已于 2026 年 6 月完成，不断增强投资者的获得感。

八、聚焦“关键少数”，强化合规履职

公司高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续加强与“关键少数”的沟通交流，不断提升“关键少数”的履职能力。报告期内，公司围绕公司治理、合规履职等主题，积极组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、北京证监局、北京上市公司协会等组织的专题培训，确保董事、高级管理人员等及时了解最新法律法规、掌握监管动态，不断增强合规意识，持续提升董事、高级管理人员的履职能力与管理经营水平，推动公司持续规范运作。

九、其他事宜

公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年8月14日